

Title	低速イオン散乱および低速電子線回折によるSi (111) 表面構造に関する研究
Author(s)	藪内, 康文
Citation	大阪大学, 1984, 博士論文
Version Type	
URL	https://hdl.handle.net/11094/33871
rights	
Note	著者からインターネット公開の許諾が得られていないため、論文の要旨のみを公開しています。全文のご利用をご希望の場合は、 〈a href="https://www.library.osaka-u.ac.jp/thesis/#closed"〉 大阪大学の博士論文について 〈/a〉 をご参照ください。

Osaka University Knowledge Archive : OUKA

<https://ir.library.osaka-u.ac.jp/>

Osaka University

氏名・(本籍)	やぶ 藪	うち 内	やす 康	ふみ 文
学位の種類	工	学	博	士
学位記番号	第	6 4 6 4	号	
学位授与の日付	昭和 59 年 3 月 24 日			
学位授与の要件	工学研究科 電子工学専攻			
学位論文題目	学位規則第 5 条第 1 項該当 低速イオン散乱および低速電子線回折による Si (111) 表面構造に関する研究			
論文審査委員	(主査) 教授 埜 輝雄			
	教授 中村 勝吾	教授 中井 順吉		

論文内容の要旨

本論文は Si (111) 表面における金属 (Au, Pd, Sn) 薄膜の成長初期過程とこれら金属により誘起された Si (111) 表面超格子構造に関する研究をまとめたもので 8 章と付録とから成っている。

第 1 章は緒論であって、本研究の目的、意義、採用した構造解析の方法と成果等について概要を述べている。

第 2 章では、低速イオン散乱分光法 (ISS) の原理とその表面構造解析への適用について述べ、利点と問題点を論じている。

第 3 章では、低速電子線回折・平均化強度法 (LEED/CMTA 法) の原理を説明し、この方法の構造解析能力について論じている。

第 4 章では、実験装置および実験方法について詳しく述べている。

第 5 章では、Au/Si (111) 系に対する研究がまとめられている。すなわち、Si (111) 表面における Au 薄膜の成長過程、および Au により誘起される (5×1) 、 $(\sqrt{3} \times \sqrt{3})$ 、および (6×6) 格子の構造解析を行い、得られた結果を従来提案されているモデルと対比して論じている。また、ISS における Ne^+ イオンの中性化率についても述べている。

第 6 章では、Pd/Si (111) 系に対する研究がまとめられている。この系に対しこれまでに行われた研究の概要を述べ、Pd-Si 固相反応によって生成する Pd₂Si 層のエピタキシャル成長条件を明らかにし、新らしく発見した $(\sqrt{3} \times \sqrt{3})$ 構造の解析を行っている。また Ne^+ イオンの Pd による中性化率をも論じている。

第 7 章では、Sn/Si (111) 系に対する研究がまとめられている。すなわち、 $(\sqrt{3} \times \sqrt{3})$ 、

($2\sqrt{3} \times 2\sqrt{3}$) , および (1×1) 格子の出現条件を明らかにし、等温熱脱離の実験結果を参照して構造解析を行っている。また Ne^+ イオンの Sn による中性化率をも論じている。

第8章は総括であって、以上の研究結果をまとめている。

付録では Si , Au , Pd , Sn に対する原子散乱因子を Herman - Skilman のポテンシャルに基づいて計算し、入射角 ($8^\circ \sim 20^\circ$) をパラメータとして図示すると共に、内部電位が CMTA 強度曲線に及ぼす影響をも図示している。

論文の審査結果の要旨

Si 単結晶表面に数原子層以下の金属を真空蒸着するとき、金属の種類、蒸着量、基板温度によって種々の表面超格子が出現する。これらの表面構造を解明することは表面科学は勿論、半導体技術において基本的な重要性を持っている。表面、或は界面物性の真の理解は構造の知識があって初めて可能となるからである。しかし、大きな表面格子における原子位置の決定は解析の困難さのため、現在まで殆んど行われていない。本研究は Si (111) 表面上の ($\sqrt{3} \times \sqrt{3}$) - Ag , および ($\sqrt{3} \times \sqrt{3}$) - Pb に適用して成功を納めた ISS - LEED · CMTA 組み合わせ法を更に改良し、Au , Pd , Sn / Si (111) 系の超格子構造の解析を行ったもので、主な成果は以下のように要約される。

- (1) Au / Si (111) 系, 1) 室温基板上では Au はランダムな方位に成長し、被覆度 θ が 3 ML (モノレイヤー) を越えると Si と反応し相互拡散が生起するが、Si は Au 層表面に析出しない。2) 高温 (700°C) 基板上では $\theta_{\text{Au}} = 0.4 \text{ ML}$ で (5×1) , IML で ($\sqrt{3} \times \sqrt{3}$) , 1.5 ~ 1.8 ML で (6×6) 超格子が形成され、(5×1) 格子は最外層 Si の下約 0.5 \AA の位置に沈んで配列している構造、($\sqrt{3} \times \sqrt{3}$) は Ag の場合と異なり、Au と Si はほぼ同一面に配列した構造、(6×6) の最外層は Au のみではなく、10%以上の Si 原子を含む構造である。3) Ne^+ イオン (500 eV) が Au で散乱される時の中性化率は上記三種の超格子を通じて等しい。
- (2) Pd / Si (111) 系, 1) 固相反応により生ずる Pd_2Si のエピタキシャル成長は基板温度 200°C 以下で蒸着し、後に $300 \sim 700^\circ\text{C}$ で熱処理するか、基板温度を $300 \sim 400^\circ\text{C}$ に保って蒸着する場合に起り、蒸着時の基板温度が 450°C 以上では起らない。2) ($\sqrt{3} \times \sqrt{3}$) 格子においては Pd 原子は Si の表面二重層の下、最外層 Si から約 1.1 \AA 沈んだ位置に配列する。3) Ne^+ イオン (500 eV) が Pd で散乱される時の中性化率は、Pd が金属として存在している場合でも、Si 上で孤立して吸着している場合でも等しい。
- (3) Sn / Si (111) 系, 1) ($\sqrt{3} \times \sqrt{3}$) , ($2\sqrt{3} \times 2\sqrt{3}$) , (1×1) 格子に含まれる Sn 量はそれぞれ $1/3$, 1 , 1 , ML である。2) ($\sqrt{3} \times \sqrt{3}$) 格子は Sn が Si 表面上 $0.1 \sim 0.4 \text{ \AA}$ の位置に存在し、($2\sqrt{3} \times 2\sqrt{3}$) は $\sqrt{3} \times \sqrt{3}$ 表面に $2/3 \text{ ML}$ の Sn が吸着した構造と推定される。(1×1) は Si 表面上 1.3 \AA の位置に Sn の単原子層が乗った構造である。3) Ne^+ イオン (500 eV) が Sn で散乱される場合の中性化率は上記三構造を通じて等しい。

(4) 上記三種類の系のすべての構造はSiの表面下数原子層に及ぶ緩和構造を伴う。

以上の通り, 本論文はこれまで想像の域を出なかったSi表面上の金属を含む若干の超格子の構造を初めて明らかにすると共に, ISSの応用上重要なイオン中性化率に関して有用な実験結果を得ており, 表面科学は勿論, 半導体工学に寄与する所大である。よって本論文は博士論文として価値あるものと認める。